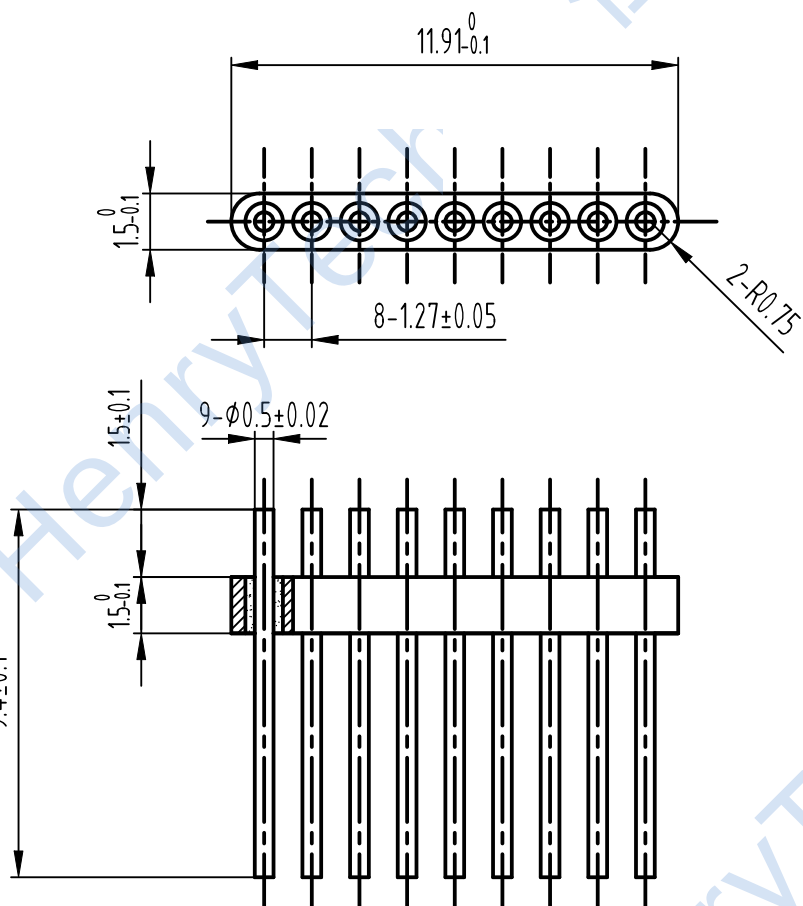




借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

签 字

日 期

						装 配 图			HN-LP9-0.5-1.27(9.4-1.5)
									成都恒利泰科技有限公司
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	设计	M.		标准化				1:1	
	审核								
	工艺			日期		共 页	第 页		